

固定衰减器芯片

- ◆ DC to 26.5 GHz
- ◆ 1 dB
- ◆ 200mW

特性

- 薄膜
- 高衰减精度
- 低驻波比
- 陶瓷芯片: 99% 氧化铝
- 激光调阻
- 高性价比

型号描述

FACXXXXX

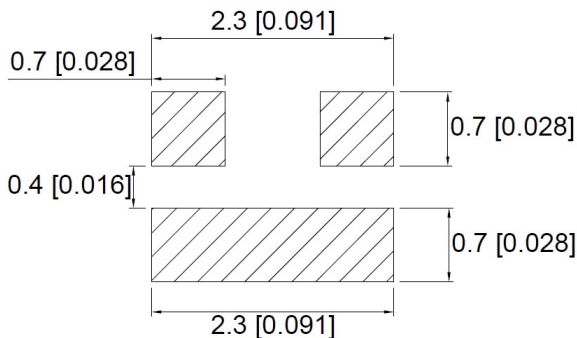
X- 焊接方式 A or B

XX- 衰减量: **dB.

XX- 频率范围 06: DC to 6GHz
 10: DC to 10GHz
 12: DC to 12.4GHz
 18: DC to 18GHz
 26: DC to 26.5GHz.

焊接方式 A: 此金电极系列只适用于邦定焊接。
 焊接方式 B: 此金电极系列只适用于无铅回流焊。

推荐 Layout



技术指标

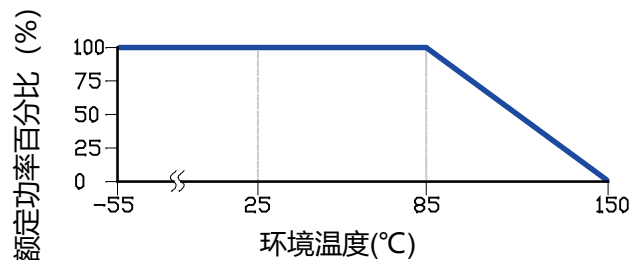
| | |
|------------|---|
| 频率范围 | DC to 26.5 GHz |
| 衰减量 | 1 dB |
| 衰减精度 (典型值) | ±0.5 dB DC to 8.5 GHz + 0.5 dB 8.5 to 12.4 GHz + 0.5 dB 12.4 to 18 GHz + 1.0 dB 18 to 26.5 GHz |
| 衰减稳定度 | 0.0001 dB/dB/°C |
| 阻抗 | 50 Ohm |
| 额定输入功率 | 200mW |
| 工作温度 | -55 °C to +150 °C |

| 频率范围 (GHz) | VSWR(:1)典型值 |
|-------------|-------------|
| DC to 8.5 | 1.05 |
| 8.5 to 12.4 | 1.10 |
| 12.4 to 18 | 1.15 |
| 18 to 26.5 | 1.40 |

材料规格

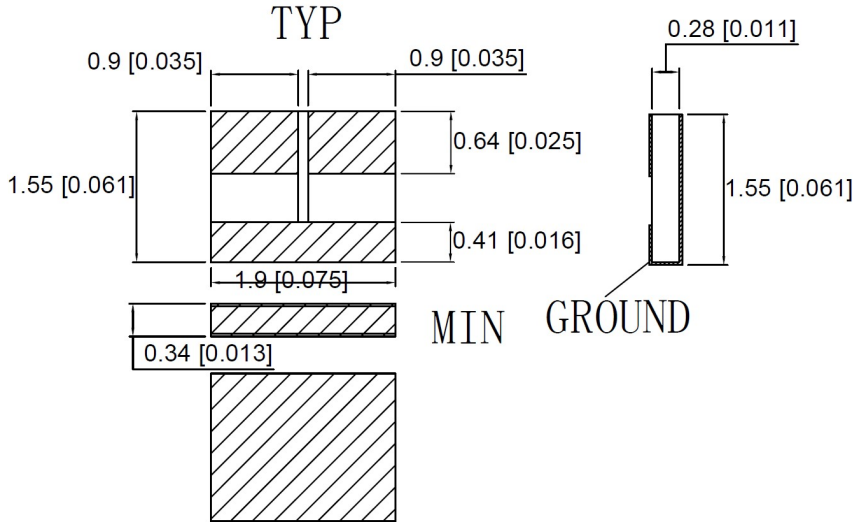
| | |
|------|----------------------|
| 介质基板 | 99% 氧化铝 |
| 电极 | 钨钛/镍/金 金厚度 : 3 μm |
| 电阻 | TaN 薄膜 |

平均功率降额曲线

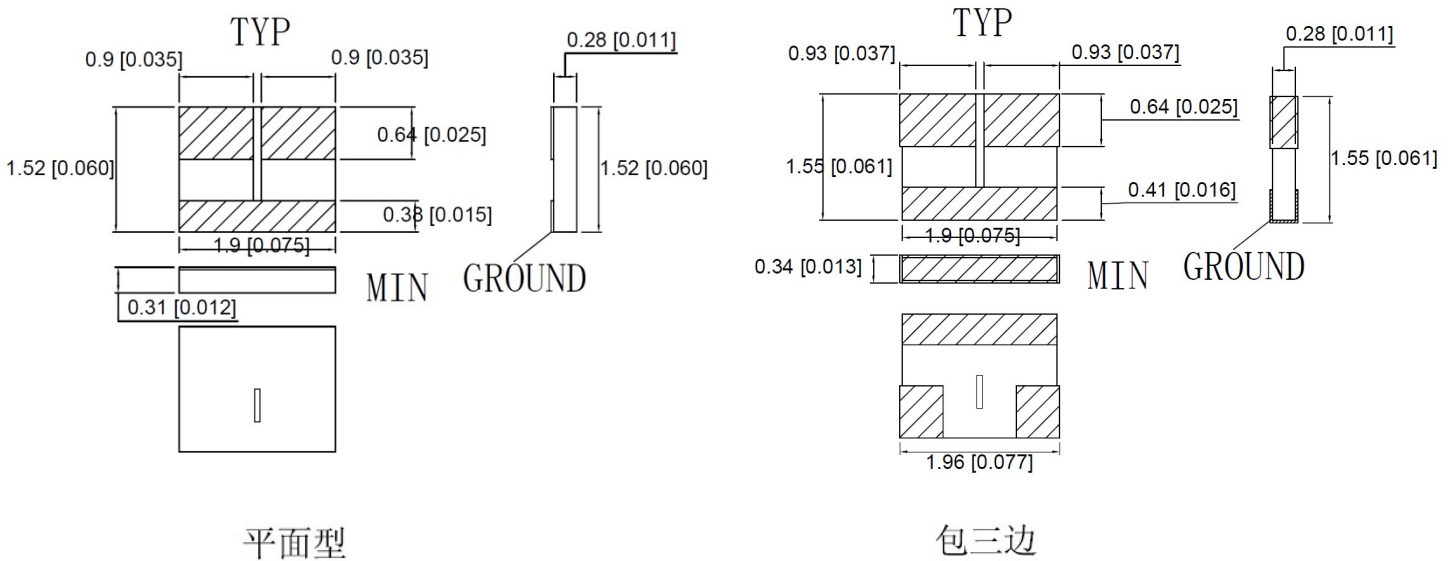


外形尺寸

A, 金丝键合



B, 无铅回流焊 (后缀无代码表示平面型, W3 表示包三边)



注: 所有尺寸均用毫米[英寸]标示